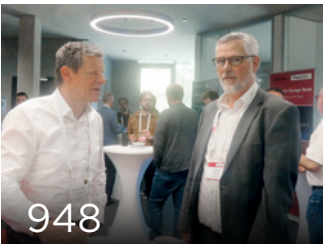




INHALT

August 2025

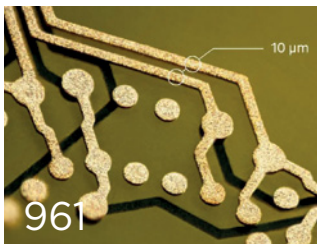
938
Für den Automotive-Markt wurden neue Gewindeanschlüsse zur Leiterplattenmontage im Pressfit-Verfahren entwickelt



948
Bei Würth in Künzelsau wurde ein Blick auf Design, Simulation und Fertigung geworfen



954
H.-J. Friedrichkeit zeichnet den bitteren Niedergang der Laminatindustrie nach



961
Die SAP-Technik ermöglicht miniaturisierte Leiterzüge für die Medizintechnik

EDITORIAL

Advanced Packages 921

AKTUELLES

NEWS & Trends 925

TERMINE & Events 933

BAUELEMENTE

Pressfit-Leiterplatten-Gewindeanschlüsse für den Automotivemarkt 938

BAUELEMENTE

1.200-V-Siliziumkarbid-Dreiphasen-MOSFET-Brücke 939

Effizientere Kühlmethoden in Servern 940

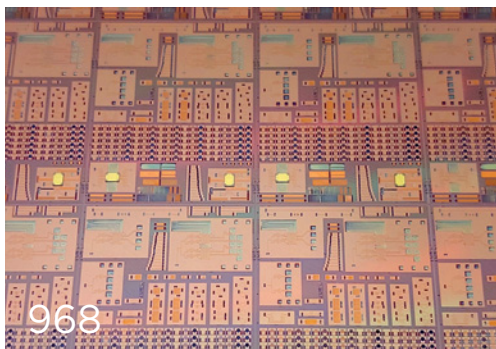
DESIGN

Ein Blick auf Design, Simulation und Fertigung 948

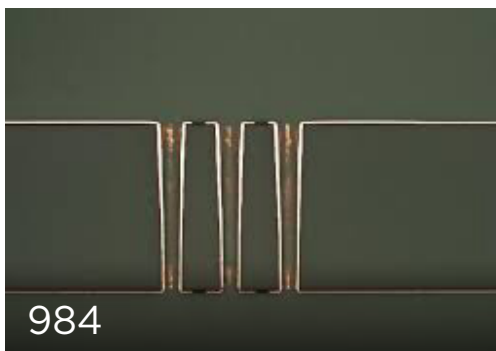
LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit):
Der Niedergang der LP-Basismaterial-Industrie 954

Miniaturisierung von Leiterstrukturen 961



Die ECTC 2025 in Texas positionierte im Mai Advanced Substrates als Schlüssel zur KI-Skalierung



Durch ihre thermischen und mechanischen Vorteile werden Glass-Core-Substrate zur interessanten Interposer-Alternative

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Glass Core, RDL und die Rückkehr der Substratfrage 968

„all about automation“ in Heilbronn 971

ANALYTIK & TEST

Software-Portfolio für normkonforme EMV-Messungen 978

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Advanced Substrates · Glass Core Substrates 984

FORUM

Neue Ausbaupläne bei Sachsens
Auftragsfertigern für Mikroelektronik 991

Für jede Anwendung die passende Inspektionslösung

◁ 3D-Messfähigkeit auf dem höchsten Stand der Technik

◁ Benutzerfreundliche Software-Integration

◁ Programmierung und Optimierung auf Basis künstlicher Intelligenz



Koh Young Europe GmbH
Industriegebiet Süd E4 · 63755 Alzenau
Tel. 06188 9935663
E-Mail: europe@kohyoung.com
www.kohyoung.com



Bericht aus Sachsen: Nach der TSMC-Ansiedlung ist die Mikroelektronikbranche im Investitionsfieber

FORUM

PlattenTektonik (J. Kostelnik): Smart Human Robotics	996
Anders Gesehen (A. Rahn): „Die Feder ist mächtiger als das Schwert“	999
PLUS-Firmenverzeichnis	1002
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	1028
Inserentenindex	1029
Mediadaten	1030
Impressum	1031
Gespräch des Monats: Tanja Knott, Business Director FLEET Events GmbH	1032

Titelbild



PIEK feiert 2025 sein 60-jähriges Bestehen. 1965 von Jo und Liesbeth Walls gegründet, entwickelte sich das Unternehmen unter der Leitung ihrer Söhne Ben und Rob zu einem international tätigen Schulungspartner für die Elektronikfertigung.

PIEK bietet das gesamte Spektrum an IPC-Zertifizierungen sowie individuelle Schulungen durch erfahrene Master-Trainer. Branchen wie Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Medizin und Automotive vertrauen seit Jahrzehnten auf das Know-how. Ergänzt wird das Angebot durch Beratung und Audits – praxisnah, kompetent und weltweit gefragt.

www.piektraining.com

Die Fachzeitschrift *PLUS* enthält exklusive Mitglieder-Informationen folgender Fachverbände:



Fachverband Elektronik-Design e. V.
Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

950



EIPC – Der Europäische
Elektronik-Verband
Tel. +31 46 4264258
www.eipc.org

958



Fachverband Electronic
Components and Systems
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

965



Fachverband PCB
and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS
AND PACKAGING SOCIETY –
Deutschland e. V.
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

974



Forschungsvereinigung
Räumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e. V.
Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de

980



DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0
romina.krieg@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

990